

## ステークホルダーの皆様へ



澤部 肇 代表取締役社長

### 2002年3月期は減収・減益に

2002年3月期の業績は、連結売上高で前期比16.7%減少し、5,750億29百万円、当期純利益は前期の439億83百万円に対してマイナス257億71百万円となりました。

売上高減少の要因を製品別に見ますと、電子材料製品と電子デバイス製品では、携帯電話やPCを中心とするIT需要が急速に冷え込んだことと、同分野における過大な需要予測見込みに起因する得意先での大幅な在庫調整期間が長引いたこと、さらに年度後半から進んだ米国における景気減退等の結果、売上高、利益ともに大幅に減少しました。

一方、記録デバイス製品は、主要製品であるHDD用ヘッドが、上期30ギガバイト/ディスク製品市場での劣勢と、PCの需要低迷によるHDDメーカーの生産調整の影響を受けて低調に推移しました。下期に入り40ギガバイト/ディスク製品へ移行していく中でマーケットシェアも上昇し、HDD用ヘッドの売上高減少に歯止めをかけることができましたが、通期の売上高としては前期と比較して減少しました。また、売上高減少の継続的かつファンダメンタルな要因として、HDD用ヘッドの面記録密度の急速な上昇によって、HDD1台当たりのヘッドの平均個数が減少していることもあげられます。

記録メディア・システムズ製品部門の売上高は微増でした。その中で、オーディオテープ、ビデオテープは、光ディスクへのシフト等により需要が減退し続けており、売上高が前期に引き続き減少しました。光ディスクの主要な売上高を占めるCD-Rは、対前期比で売価が下落したものの、数量ベースで増加したため売上高は増加しました。また、前期秋ごろから米国で発売を開始したレコーディング機器も、当期は欧州でも販売を開始したため、売上高増加に寄与しました。当期スタート時点では、この部門全体での営業損益黒字化を予定していたものの、CD-Rの売価下落等の要因で、残念ながら赤字から脱却できませんでした。

以上のように当期の業績悪化には、アメリカの経済の低迷、ITバブルが調整段階に入ったこと、また中国・台湾を中心とした国々との競争激化などの外的要因があります。さらに、内的要因に目を向けますと、変化に対する認識の遅れ、あるいは認識してからの行動の遅れという要因がありました。このような認識のもと、当期は、今後の損益分岐点の早期引き下げを目指して、固定費及び変動費の削減、さらに資産効率の向上のために国内外の生産子会社の統廃合を実施するとともに、市場のニーズに、よりスピーディに対応できる組織の改編と開発体制の見直しも実施しました。この結果、これらの収益構造改革に要したリストラ費用を当期258億72百万円計上いたしました。

## 2003年3月期の基本方針

米国の経済指標に良い数値が出だし回復に向かい出しましたが、その回復は脆さを内包しており、スローなものになると思われま。またTDKの国内外における受注も少しずつ増加傾向に転換し始めましたが、電子部品や半導体の本格的な回復を確かにし、新しい需要を喚起するだけのリーディング製品が見当たらないという不安材料もあります。そして構造的にはネット社会におけるスピードと競争の激化、中国の台頭、EMS (Electronics Manufacturing Service) の存在、ICとの関わり、供給過剰等、電子部品業界を取り巻く経営環境は依然として厳しい状況下にあります。特に2003年3月期は販売価格と為替が不安定要因だと考えております。

TDKでは、この2003年3月期を非常事態の期と認識し、まず損益分岐点を引き下げて可能な限り早期に黒字体質に転換すること、他社に対して優位性のある商品を少しでも早く開発し、成長すること、そして経営資源である資金は大切に使うこと。これらを同時並行的かつスピーディに実施してまいります。

また、基本となる最大の目標は、売上が伸びない状況でも収益を確保できる体制づくりと、収益性や成長性の低い分野から高い分野への経営資源の移動を行い、選択と集中を確実に実行していくことです。

## 収益構造の改革について

### ● 固定費、変動費の削減及び資産効率の向上

2002年3月期には、損益分岐点の引き下げを目標に日本国内で3,257名、海外で4,511名の人員削減を行いました。その効果として、この2003年3月期に連結ベースで労務費約230億円の削減を見込んでおります。さらに、固定費削減につきましても、2003年3月期に145億円の目標を設定し、削減を進めております。また、資産効率の向上のために国内4工場及び海外3工場の統廃合を実施するとともに、市場のニーズに、よりスピーディに対応できる組織の改編と開発体制の見直しも実施しました。さらに、資材購入におけるベンダーの見直しやコストダウン要請による変動費の改善を進めております。

#### ● 選択と集中 — 事業撤退基準の明確化

2003年3月期も、電子部品の供給能力過剰と得意先がコストダウンを推し進めていることから、販売価格の低下が予想されますが、この販売価格低下をカバーして売上・利益を確保していくためには、開発リードタイムの短縮、開発費効率の改善、新製品の売上比率拡大および商品と事業の選択と集中を強化・実行していかなければなりません。

2003年3月期は、これまでなかなか進まなかった選択と集中による構造改革を推進してまいります。具体的には過去2年間TVAがネガティブなものをクリティカル・ビジネス・ユニットと定義し、そのNPV（Net Present Value=現在価値）に基づいた事業計画を多面的に徹底検証してまいります。また、3年以内にNPVの黒字化が見込めないものは原則撤退とし、3年以内に黒字化が見込めるものでも半年ごとの検証を徹底的に進めてまいります。

#### ● キャッシュフローの改善

これまでTVAなど、いろいろな指標を作りましたが、結果的には資産の効率化が充分には図られてきませんでした。今後は、製造の末端にまで分かりやすい目標設定を行い、キャッシュフローの改善を進めてまいります。

### 成長戦略の遂行について

企業は従業員や株主をはじめとするステークホルダーの皆様方にエキサイティングな価値を提供していくために、質的にも量的にも常に成長し続けなければなりません。また、特長あるもの、すなわち他社に対して優位性のある製品の比率を増やし、結果として売上を拡大していかなければなりません。そのためにもTDKは“e-material solution provider”として、TDKのコアコンピタンスを活かし、「TDKの香り」のする製品、すなわち他社の追随を許さない独創的製品を市場・顧客変化にタイムリーに対応しながら提供し続けてまいります。以下は、そのための今後の取り組みです。

#### ● 高機能材料、ファインプロセス技術の強化

TDKは、フェライトという材料を他社に先がけて事業化し、この磁性材料製品を製造する技術を応用して誘電体も商品ラインナップに加えました。この磁性体と誘電体を中心とした材料技術こそがTDK最大の強みであり、また、電子部品やテープ、磁気記録ヘッドの製造における成膜、粉体制御、焼成、コーティング並びに微細加工というプロセス技術も高いレベルにあると自負しております。TDKでは現在のような市場環境を踏まえ、これまで蓄積してきた強みである材料技術とプロセス技術という原点に

立ち返り、今後は高機能材料とファインプロセス技術に注力してまいります。プロセス技術では、セットの小型・軽量化が進むことによる回路の高密度化を見据え、既存材料のファイン化対応、ナノスケールでの微細加工、成膜工法等を強化してまいります。

#### ● 商品企画機能の強化

やはり、企業の進めるべき商品の開発・提供は“顧客のニーズに合った”ものでなければなりません。これは、商品の特性(仕様等)、市場の要求、さらに時間軸としてのタイミング及びベンチマーキングをマトリックスで掛け合わせた商品企画にしっかりと立脚したものでなければなりません。また、この商品企画機能の強化こそが商品及び事業分野における選択と集中を可能にし、ひいては経営資源の適正配分化が実現されるものと考えています。

#### ● シミュレーション評価技術の強化とセントラルデータベース構築

開発リードタイムの短縮化を図るために、シミュレーション評価技術を強化してまいります。これにより試作時のカット&トライに要する時間やエネルギーがかなり効率化されると考えております。また、これらに加えファンクショナルブロック開発技術等を通じて蓄積されていく様々な技術的ナレッジを、各部門でしっかりと管理していくとともに、全社レベルで集約し、本社研究部門にてセントラルデータベース構築を行います。開発にかかわる関係者間でのナレッジの共有化を推進し、部門間の壁を越え、さらなる開発リードタイムの短縮等、全社一丸となって技術の活性化が図れる環境の構築を急ぎます。

#### ● 半導体技術力と回路技術力の強化

商品を企画する上で、また、それを具現化するTDKの基盤技術を駆使する上で、何よりも重要なことは、顧客であるセットメーカーの皆様と同じフィールドに立ち、同じ目線で同じものを見て考えることです。それはユーザーの方々に対してどのような機能を求めているかであり、またこのセットの機能を定めるものが「回路」であり、さらにこの「回路」の動向を決めるものこそ「IC」です。

また、今後TDKが追求していく「ファンクショナルブロック」とはセットの機能の一部であり、顧客が困っていること、使い勝手を良くすること等に対してソリューションを提供するものです。これを具現化するには様々な方法があります。ある場合はモジュールで対応しなければいけないかもしれませんが、また別の場合はチップコンデンサ1つで可能となる場合もあります。また、コイル(インダクタ)、電源等を独自に組み合わせて提供するのがベストな時もあります。今まさにTDKに求められているのは、TDKの持つ様々な製品や技術の中から、何をどう駆使すれば、顧客にとって最適な「ファンクショナルブロック」を、

品質、納期、コストの最適化を考慮しながら、提供できるのかということだと考えています。

したがって、これからの開発には高度な半導体技術と回路技術が必要不可欠なことから、今後はこの両技術の高度化に力を入れてまいります。以下はそのための重要なステップです。

1. IC動向の熟知
2. その変化・発展に対応した回路の先取り
3. その回路に適応する様々な機能、すなわち「ファンクショナルブロック」の開発
4. 「ファンクショナルブロック」具現化のための最適な材料、部品、プロセスの選定、開発

本格的な市場回復にはまだまだ時間がかかるものと予想され、現状の経営環境には厳しいものがありますが、中長期的展望に立ちますと、現在はIT革命の第一段階が終わって、第二段階に入る踊り場にあると考えております。つまり、第二段階はブロードバンドを核にしたネットワーク社会が到来し、デジタル家電も開花していくものと予想されることから、将来の展望は決して暗くはないと思っております。

このような環境のもと、2003年3月期は、前期に引き続き収益構造改革を徹底的に推し進めて収益を確保すること、そして中期的には成長戦略を着実に実施して収益性のさらなる拡大を目指してまいります。ステークホルダーの皆様方におかれましては一層のご支援、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。

澤部 肇

2002年6月

代表取締役社長 澤部 肇